

惠州光弘科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

根据公司发展战略，为推进公司打造成全球领先 EMS 企业的战略布局，提升公司综合竞争力，2024 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于参与竞拍 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权的议案》。公司拟通过在北京产权交易所摘牌并支付现金购买的方式收购 All Circuits S.A.S.（以下简称“AC 公司”）100%股权及 TIS Circuits SARL（以下简称“TIS 工厂”）0.003%股权。收购完成后，公司将控制 AC 公司及其控股的 TIS 工厂的 100%股权，AC 公司及 TIS 工厂将成为公司子公司。

经初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体情况尚待审计工作完成后方能确定。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。

公司于 2024 年 11 月 26 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-043），对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。

二、本次交易进展

公司已于 2024 年 12 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-050），于 2025 年 1 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-001），于 2025 年 2 月 17 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-002），对本次交易进展情况进行了说明。

2025 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于本次重大资产购买方案的议案》等与本次交易相关的议案。同日，公司之子公司 All

Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 与 Hiwinglux S.A.、IEE International Electronics & Engineering S.A.及 AC 公司就购买 AC 公司 100%股权签署附生效条件的《产权交易合同》，与 IEE International Electronics & Engineering S.A.及 TIS 工厂就购买 TIS 工厂 0.003%股权签署附生效条件的《产权交易合同》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日公告的《惠州光弘科技股份有限公司重大资产购买预案》等相关公告。

截至本公告披露之日，标的公司的审计、评估等相关工作正在进行中。鉴于标的公司位于境外，涉及的审计、评估等相关工作程序相对复杂，预计尚需一定时间完成。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作，后续公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露项目进展情况。

三、风险提示

本次交易尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日